

**方正证券承销保荐有限责任公司**  
**关于甬矽电子(宁波)股份有限公司**  
**2023 年度持续督导跟踪报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为甬矽电子(宁波)股份有限公司（以下简称“甬矽电子”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责甬矽电子上市后的持续督导工作。

2023 年度持续督导期间，保荐机构对甬矽电子持续督导情况如下：

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与甬矽电子签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年度，甬矽电子在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年度，甬矽电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，了解甬矽电子经营情况，对甬矽电子开展持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的	在持续督导期间，保荐机构督导甬矽电子及其董事、监事、高级管理

序号	工作内容	持续督导情况
	业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺	人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促甬矽电子依照相关规定健全完善公司治理制度,并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对甬矽电子的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查,甬矽电子的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行,能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促甬矽电子严格执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对甬矽电子的信息披露文件进行了审阅,不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,采取措施予以纠正	2023年度,甬矽电子及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告	2023年度,甬矽电子及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告	2023年度,甬矽电子不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年度，甬矽电子未发生相关情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2023 年度，甬矽电子不存在需要专项现场检查的情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

### （一）业绩大幅下滑或亏损风险

2023 年，受外部经济环境及行业周期波动影响，全球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，公司所处的封测环节亦受到一定影响。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模估计为 5,201 亿美元，同比下降 9.4%，较 2022 年出现下滑。在多重因素影响下，公司报告期内实现营业收入 239,084.11 万元，同比增加 9.82%；公司归属上市公司股东的净利润为-9,338.79 万元，同比减少 167.48%。公司预计 2024 年营收规模将持续提升，由此带来的规模效应亦会对盈利能力产生正面影响，但若未来半导体产业持续低迷或公司投资项目产能爬坡不及预期，公司业绩可能出现不及预期或亏损的风险。

## （二）核心竞争力风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展和客户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

## （三）经营风险

### 1、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括基板、引线框架、镀钎铜丝、塑封树脂、导电胶等。报告期内，公司主营业务成本中直接材料占比较高，因此原材料的价格波动会给公司毛利带来较大影响。

公司原材料价格受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响，若未来公司原材料价格出现大幅波动，而公司产品售价不能及时调整，将给公司的盈利能力造成不利影响。

### 2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的营业收入占公司营业收入的比例为 38.38%，客户集中度相对较高。若未来公司与下游主要客户合作出现不利变化，或原有客户因市场竞争加剧、宏观经济波动以及自身产品等原因导致市场份额下降，且公司未能及时拓展新客户，则公司将会存在收入增速放缓甚至下降的风险。

## （四）财务风险

### 1、存货跌价风险

公司封装所需要的原材料品类较多，且基板、专用引线框架等主要原材料交付周期受市场供需关系影响波动较大。公司为了应对原材料供应的波动性，通常会根据客户订单预测情况备有一定量的安全库存。2020年至2023年，公司存货账面价值分别为9,376.12万元、27,887.65万元、32,057.30万元和35,785.55万元，

占流动资产的比例分别为 18.04%、28.36%、17.96%和 11.93%，主要由原材料和在产品组成。2020 年至 2023 年，公司各期计提存货跌价准备金额分别为 81.57 万元、164.81 万元、352.26 万元和 753.53 万元。针对存货中原材料余额较高的情况，公司会通过生产计划和供应链管理促使原材料库存保持合理水平。若市场环境发生重大变化，公司未能及时调整库存水平，则可能出现存货跌价的风险。

## **2、毛利率波动风险**

公司主营业务毛利率存在较大波动。公司产品毛利率同产能利用率、主要原材料价格波动、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司封装产品型号众多，不同型号产品在生产加工工艺和所需原材料构成均存在一定差异，因此产品结构变化也会对公司主营业务毛利产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化，比如产能利用率下降、主要原材料价格大幅上涨或市场需求萎缩导致产品价格下降等，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

### **（五）行业风险**

#### **1、市场竞争风险**

近年来，随着我国集成电路封测行业快速发展，吸引了众多的企业进入，同时智能手机、PC 等消费类电子市场需求疲软，市场处于去库存阶段，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险，市场竞争的加剧，可能导致行业平均利润率下降，进而对公司销售额及利润率造成一定影响。对此，公司将持续加大研发投入，加强市场开拓，强化降本增效，提高产品价格竞争力，积极应对市场竞争。

#### **2、行业波动及需求变化风险**

公司主营业务为半导体行业集成电路封装测试，集成电路行业的发展状况对公司的生产经营具有重大直接影响。集成电路行业具有与宏观经济同步的特征，其波动幅度甚至会超过全球经济波动幅度。若未来宏观经济形势变化，全球集成电路产业市场出现较大波动，将对公司经营业务和经营业绩带来较大的影响。

## （六）宏观环境风险

### 1、全球经济波动的风险

目前全球经济仍处于周期性波动当中，尚未出现经济全面复苏的趋势，依然面临下滑的可能，全球经济放缓可能对半导体行业带来一定的不利影响，进而间接影响公司的业绩。未来，若国内和国外经济若持续低迷，可能导致消费者消费预期降低，进而持续影响半导体行业，对公司生产经营产生不利的影响。

### 2、产业政策变化风险

政府对集成电路行业的产业政策为我国集成电路封装测试企业提供了良好的政策环境，若国家产业政策发生不利变化，将对行业产生一定的影响。公司将持续关注市场动向、宏观经济形势、相关政策、客户需求等变化，并建立对标体系，及时调整经营发展目标和投资方向，降低相关市场风险带来的影响。

## 四、重大违规事项

2023 年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务指标及数据如下：

### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	2,390,841,120.27	2,176,992,689.58	9.82
归属于上市公司股东的净利润	-93,387,886.95	138,400,419.38	-167.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-161,909,756.67	59,308,286.37	-373.00
经营活动产生的现金流量净额	1,071,479,586.66	899,615,766.86	19.10
主要会计数据	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,448,597,504.62	2,554,143,218.39	-4.13
总资产	12,330,906,165.46	8,320,726,323.62	48.20

## （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.23	0.39	-158.97
稀释每股收益（元/股）	-0.23	0.39	-158.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.40	0.17	-335.29
加权平均净资产收益率（%）	-3.75	9.02	减少 12.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.5	3.86	减少 10.36 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.07	5.59	增加 0.48 个百分点

2023 年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

归属于上市公司股东的净利润变动原因分析：主要系需求较为疲软，产品价格承压以及新工厂建设及人员规模增加导致本期毛利下降、财务费用及管理费用上升所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因分析：主要系归属于上市公司股东的净利润下滑所致。

总资产变动原因分析：主要系新工厂建设带来的固定资产、在建工程、长期待摊费用等增加所致。

基本每股收益及稀释每股收益变动原因分析：主要系归属于上市公司股东的净利润下滑所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因分析：主要系归属于上市公司股东的净利润下滑所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### 1、客户资源优势

凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、不断提升的量产能力和交付及时性，公司获得了集成电路设计企业的广泛认可，并同众多国内外知名设计公司缔结良好的合作关系。报告期内，公司围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加大新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度，公司客户结构持续优化，与多家细分领域

头部客户建立战略合作伙伴关系，并获得多家客户颁发的战略合作供应商、最佳合作供应商、优秀战略合作伙伴等荣誉。报告期内，公司共有 11 家客户销售额超过 1 亿元，14 家客户（含前述 11 家客户）销售额超过 5,000 万元，客户结构持续优化。

## 2、技术及产品结构优势

公司具备较强的技术研发能力，自 2017 年 11 月成立至 2023 年 12 月 31 日止，公司总计取得了 119 项发明专利授权、183 项实用新型专利授权、外观专利 2 项。公司在高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、系统级封装产品、4G/5G 射频功放封装技术、高密度大尺寸框架封装产品、MEMS 封装产品、IC 测试等领域均拥有核心技术。

公司从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向，业务起点较高。因此与同行业竞争者相比，公司产品结构较为优化，销售收入主要来自中高端封装产品，并在射频前端芯片封测、AP 类 SoC 芯片封测、触控 IC 芯片封测、WiFi 芯片封测、蓝牙芯片封测、MCU 等物联网（IoT）芯片封测等新兴应用领域具有良好的市场口碑和品牌知名度。

## 3、人才优势

公司拥有完整高效的研发团队，并重视研发队伍的建设和培养，研发团队核心人员均具备丰富的集成电路封装测试行业技术开发经验。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队，可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。

2023 年度，公司的核心竞争力未发生不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出情况

公司坚持自主创新，持续进行研发投入。2023 年度，公司研发支出情况如下：



单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	145,123,234.67	121,721,504.34	19.23
资本化研发投入	不适用	不适用	不适用
研发投入合计	145,123,234.67	121,721,504.34	19.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.07	5.59	增加 0.48 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	不适用	不适用	不适用

## (二) 研发进展

### 1、在研项目情况

单位：元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	工艺能力提升研究类项目(如 Hybrid csp 产品、传感器产品等)	197,490,000	63,755,585.97	64,055,229.47	导入国产溅镀机/先进封装细线宽/距(5/5)um 开发/大颗 QFP 密间距引脚产品打线能力研究/先进植球封装产品技术开发/先进电镀锡球封装产品技术开发/CSP 工艺封装智能卡模块技术研究/叠层式 3D 封装技术研究/C-MOLD 超薄产品能力开发/高密度 QFP 封装能力/小颗 QFN 产品防止引脚分层技术	提升芯片封装工艺技术能力	行业先进	研发项目成果, 将逐步转化应用在高级消费电子产品, 以及向高可靠性/高质量要求的工规和车电产品应用

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					研究/QFN叠装多芯片密间距产品球焊线弧技术研究/SiP产品生产流程规划与建立/SMT高密度制程能力建立/超高散热FC封装工艺开发/FC封装bump虚焊研究			
2	设计仿真技术研究项目(如Delphi热阻等研究等)	2,170,000	3,063,102.77	3,063,102.77	完成热阻模型仿真效率提升等研究,输出相应的指导规则并进行新产品设计应用	提升封装芯片设计仿真能力	行业先进	对应在高算力芯片及高密度集成模组产品方向的建模仿真技术研发,已部分应用在新产品开发
3	生产工艺效率提升研究项目(如中央供酸、异常侦测系统等)	47,320,000	20,477,064.8	22,506,698.28	导入自动化生产电镀自动分析开发/自动化生产-中央供酸导入开发/自动化生产天车系统导入开发/客户特殊程序系统化管理/标签二维码比对系统/同片Wafer同时多次装片技术能	提升生产效率及品质,完善自动化建设	行业先进	推进封装生产线自动/高效化管理,提升生产效率同时提升产品品质

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					力研究/Bumping 机台异常即时侦出系统开发			
4	新材料应用开发项目(如国产基板应用研究等)	6,920,000	8,626,169.28	8,626,169.28	完成装片胶及粘接过程的工艺研究/金线长线稳定性能力研究/内埋基板封装技术开发	建立新材料技术储备及低成本材料应用开发	行业先进	结合封装产品结构/应用调整, 及材料供应链策略, 匹配需求新特性材料应用开发
5	新封装产品开发项目(如堆叠封装、Wettable flange等)	71,400,000	30,114,319.03	35,107,827.06	完成膜状底填热压键合技术研发/FCBGA 高散热 TIM (铜片) 开发/引脚外伸类产品 DDTF 能力建立/数据处理器级封装工艺开发/FC Wettable flange 工艺开发/C-MOLD 透明封装技术开发/LQFP 封装技术开发/国产 HAT 型设计单颗散热片研究及开发导入/国产 IC 透明封装塑料特性研究及开发导入/系统级 SIP 模组封	提升新产品研发能力及技术竞争力	行业先进	新产品研发覆盖消费电子/车电/IOT 等多领域, 扩宽产品线及提升在高端封装上的技术竞争力

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
					装工艺开发			
6	工能研类项目 新工艺研发项(如晶圆级封装技术系统研究等)	50,400,000	18,930,142.93	23,157,585.57	提前布局进行凸块及重布线技术/TSV/膜状底填热压键合技术/不同结构微凸点制造技术/扇入及扇出技术/Jetting flux 工艺开发\晶圆级背面打印工艺研究等研究,并在接下来的研发及生产过程中逐步推进量产;同步完成高密度多圈引脚及高焊接性能 QFN 技术/不同工艺基板倒装工艺能力提升等技术研究,并实现量产产品应用	提升新工艺开发能力及技术竞争力	行业先进	晶圆级封装技术作为 Flipchip 的前制程及向先进小芯片 (Chiplets) 技术发展,已广泛应用于消费电子/工控/通讯/大基建/物联网等各行各业,前景广阔
合计	/	375,700,000.00	144,966,384.78	156,516,612.43	/	/	/	/

## 2、报告期内研发成果

2023 年度,公司新增申请发明专利 27 项,实用新型专利 74 项,外观设计专利 1 项;新增获得授权的发明专利 16 项,实用新型专利 63 项。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2286号），同意公司向社会公众发行人民币普通股（A股）股票6000.00万股，发行价格为18.54元/股，募集资金总额为111,240.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币10,332.10万元后，实际募集资金净额为人民币100,907.90万元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月11日出具了《验资报告》（天健验[2022]608号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用及结余情况具体如下：

金额单位：人民币元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	1,009,078,959.63	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	784,008,538.42
	利息收入净额	B2	862,313.87
本期发生额	项目投入	C1	227,361,501.94
	利息收入净额	C2	1,190,751.47
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,011,370,040.36
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,053,065.34
应结余募集资金	E=A-D1+D2	-238,015.39	
实际结余募集资金	F	0	
差异[注]	G=E-F	-238,015.39	

[注] 实际结余募集资金与应结余募集资金差异238,015.39元，其中：差异252,332.82元系公司自有资金垫付募集资金股权应支付的印花税导致；差异14,317.43元系公司募集资金专户结余利息导致。截至2023年12月31日，公司已将募集资金专户中的余额合计人民币14,317.43元（含利息），已全部转入公司自有账户永久补充流动资金，并办理完成四个募集资金专户的注销手续。

截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司宁波余姚泗门支行	307006227013000113260	0	已销户
中国银行股份有限公司余姚分行	387081898936	0	已销户
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	33150199523600001604	0	已销户
中国农业银行股份有限公司余姚分行	39633001040010780	0	已销户
合计		0	

公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东为浙江甬顺芯电子有限公司，持有公司 74,210,000 股股份，持股比例为 18.20%。2023 年度，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。2023 年度，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

2023 年，公司归属于上市公司股东的净利润-93,387,886.95 元，同比减少 167.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-161,909,756.67 元，同比减少 373.00%。

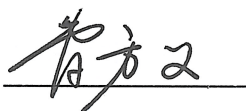
公司 2023 年较上年同期由盈转亏，主要原因系受外部经济环境及行业周期波动影响，全球终端市场需求依旧较为疲软，下游需求复苏不及预期，公司所处的封测环节亦受到一定影响。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模估计为 5,201 亿美元，同比下降 9.4%，较 2022 年出现下滑。保荐机构已在本报告之“三、重大风险事项”之“（一）业绩大幅

下滑或亏损风险”对相关风险进行提示。

未来，保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

(此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于甬矽电子(宁波)股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：



曹方义



李广辉

方正证券承销保荐有限责任公司

